

1

2

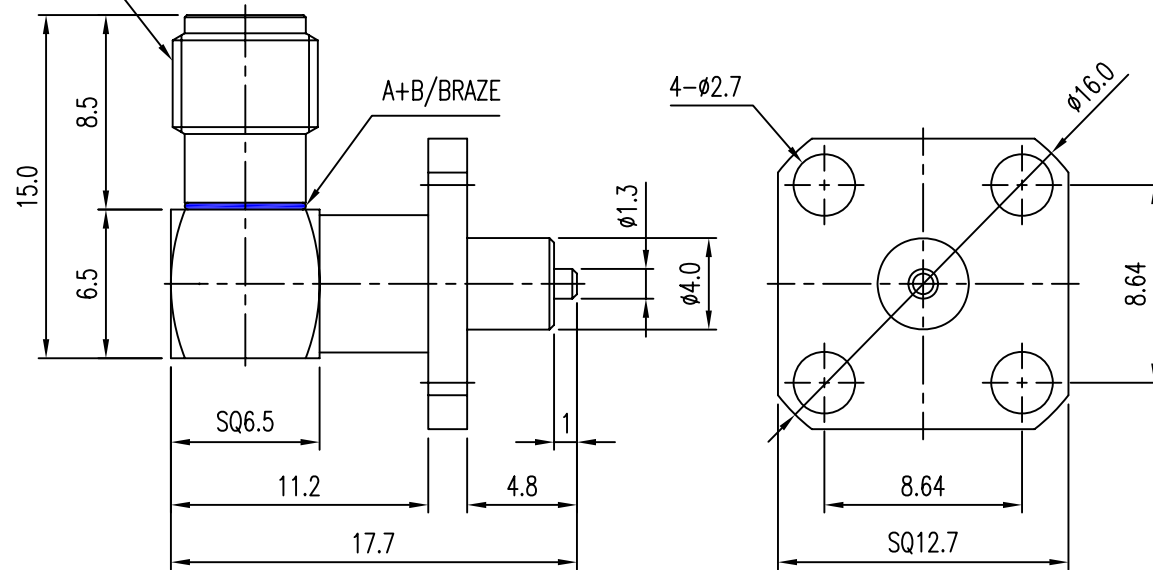
3

4

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	생산성 향상(절면No. 2005-168) (뿔공정시 PIN 밀림현상 개선으로 인해 뉘시배늘 추가)	김인철	최충락	2005. 7. 20.
2	신뢰성 향상 (절면No.연 2006-149) (PIN 밀림 방지 뉘시배늘 삽입)	김인철	윤상진	2006. 7. 27.
3	배타 PUNCH -> HOOK 변경 및 A-B/은뿔 구조 변경	은선영	김인철	2021. 5. 10.

1/4-36 UNS-2A



7	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00041-5/2 (L3009)	
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00240-N/1 (H2272)	
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00112-N/1 (H2031)	
4	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00117-5/1 (E2406)	
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00151-5/1 (E2127)	
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00167-5/5	DBD02134-1/3 DBD00229-1/5
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00069-5/1	DBD00229-1/5 DBD00228-1/5

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일	2004. 3. 4.				
소수 각도 분수	승인					
재질	검도					
열처리	제도					
보호피막처리	작성부서	연 구 소				
	적도	3/1	단위 mm	중량		



도명 SMA-LJ-H4-R

도번 CN01409-7/1

A4 K314-620-008